

トピックス

◎絶縁型DC-DCコンバータ「Senseiシリーズ」を商品化！



電子機器内の多様な電力要求に対応した分散化電源方式に向け、絶縁型DC-DCコンバータ「Senseiシリーズ」を開発し、商品化いたしました。

「Senseiシリーズ」は、昨年商品化した非絶縁型DC-DCコンバータ「Senpaiシリーズ」と同様、あらゆる環境下においても高効率の電力供給を行なうというコンセプトで開発し、高信頼性が要求されるネットワーク機器やサーバ、計測機器などにバスコンバータとしてご使用いただけます。

◎WiMAX向け超小型積層チップパランを開発！



大容量の高速無線データ通信として広範囲な電波到達距離と高速での移動通信を可能にするWiMAX向けに、超小型積層チップパランを開発いたしました。1608タイプとしては世界最高性能となる0.6dB（デシベル）という低挿入損失を実現し、高周波回路において平衡・不平衡回路間のインピーダンスマッチングに使用されます。

携帯電話、PDA、カーナビなどのWiMAX機器市場に向けて拡販を展開してまいります。

◎積層チップパワーインダクタの生産能力増強



携帯電話などモバイル機器向けに、積層チップパワーインダクタの需要が拡大しています。当社の積層チップパワーインダクタは、小型化・高性能化に成功し、製品ラインアップの充実に努めたことから受注が増加しており、この需要増に対応するために、同製品を製造しております湖西工場において生産能力を現行の倍に増強いたします。

今後につきましても世界市場を見据えながら、当製品の生産増強を進めてまいります。

◎『TECHNO-FRONTIER 2007』へ出展



4月18日（水）から20日（金）までの間、幕張メッセ（千葉県千葉市）において開催された固有技術の専門性と複合技術の総合性を併せ持つ国内唯一最大規模の技術展示会である『TECHNO-FRONTIER 2007』に出展いたしました。今回は、「DC-DCコンバータ（Senpai&Senseiシリーズ）」、「積層チップパワーインダクタ」などを中心に紹介し、多くの方々に関心を持っていただくことができました。